## Mehrschichtplatte, 26L HDI PCB, FR-4

**Produktbeschreibung:** 

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung	
Basismaterial	NPG-150N	Kupfer Dicke	1 Unze	
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	2.35mil	
Oberflächenbearbeitung	Immersives Gold	Mindest. Zeilenabstand	3mil	
anwendbar auf	Industrie Kontrolle	Charakter	Industrielle Kontrolle	
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS	
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück	
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Plattendicke	0,1-5mm	
Farbe	Grün	Preis	\$ 0,1- \$ 10	
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3	

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Client-Board-Hersteller
Lieferdetails	7-12days

## Produktbeschreibung

Artikel	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023			
Artikei	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe		
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48		
Min Linie / Abstand (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35		
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10		
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1		
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6		
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6		
Plattenfüllung via	JΑ	-	JA	-	JA	-		
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (μm)	50	40	40	dreißig	40	dreißig		
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (μm)	75	65	65	50	50	40		
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-		
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.							
Eingebettete Kondensator-Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	-		
Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Silber mit Eintauchen, Zinn des Eintauchens, Goldblitz, goldene Fingerbeschichtung, selektive Goldbeschichtung, Abblätternde Lötmaske, Kohlenstoff ink							

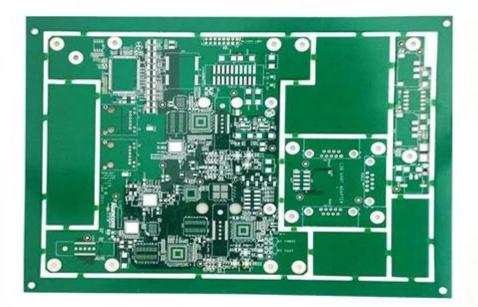












www.o-leading.com

HDI-Leiterplatte Leiterplatte